

【東京/武蔵村山】電気設計（半導体製造装置）　◆ヤマハ発動機グループ

ヤマハロボティクス株式会社での募集です。 機械設計・機構設計・筐体設計・メカト...

募集職種

人材紹介会社
株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント

採用企業名
ヤマハロボティクス株式会社

求人ID
1594389

業種
電気・電子・半導体

雇用形態
正社員

勤務地
その他東京

給与
500万円 ~ 850万円

勤務時間
08:45 ~ 17:30

休日・休暇
【有給休暇】有給休暇は入社後4ヶ月目から付与されます 初年度 採用月に応じて2日 ~ 15日 4か月目から 【休日】完全週休二日制...

更新日
2026年10月31日 02:00

応募必要条件

キャリアレベル
中途経験者レベル

英語レベル
無し

日本語レベル
ネイティブレベル

最終学歴
専門学校卒

現在のビザ
日本での就労許可が必要です

募集要項

【求人No NJB2379214】
■業務内容：
半導体製造装置の開発において、顧客要望のヒアリングから仕様検討、設計、出図業務、試運転立ち合いまで幅広くお任せします。半導体は日々進化することから、新機種開発やカスタマイズ設計にも面白みがあります。

■担当製品：ワイヤボンダ/ダイボンダ等
https://www.yamaha robotics.com/products/manufacturer?maker=%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%96%B0%E5%B7%9D

■本ポジションの魅力：
魅上流から下流まで範囲広く設計に携われるため、自分が作った装置である実感値を得られやすいです。また、この装置によって作られた半導体は日々進化しており、最先端技術に触れながらお仕事できるのも魅力。また対峙するのは世界トップの半導体メーカーです。
・装置の面白み…超微細な世界の中で高速かつ精度の高さが求められる面白さがあります。

※残業想定時間：20時間程度を想定

■半導体ボンディング装置のパイオニア企業
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1970年代後半、それまで人の手で行われていたワイヤボンディング（半導体製造における後工程作業）の全自動化に成功したのは当社です。競合が増えた今、当社の強みは品質No.1であり仕様に沿ってカスタマイズ設計ができること。この丁寧さは今後も捨てずに、日本企業としての自信・自負をもって世界No.1であり続けるのが私たちの目標です。

□主力製品「フリップチップボンダ」について
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

半導体製造のための精密ロボットです。
ウェハー上に形成された半導体素子を、反転（フリップ）させて基板上
もしくはウェハー上へボンディングする為の装置で、従来のワイヤボンディングに
替わる新しい実装技術になります。
最新のスマートフォンやデータセンタの中心的な役割を果たすICを
製造する為の装置です。
メカトロニクス技術はもちろん、制振制御、ロボティクス、材料工学、
画像処理技術などあらゆる最先端の技術がつまっています。

スキル・資格

~ 業界未経験歓迎 / 業種未経験歓迎 ~
■必須条件：下記いずれかに該当する方
・高専・大学・大学院などで電気電子系の学部学科を卒業している方
・電気設計のご経験
・設備設計のご経験（電気）

■歓迎条件：
・電気電子回路、FPGA回路、モータ制御、半導体製造装置の開発のご経験をお持ちの方

会社説明

ヤマハロボティクス株式会社（Yamaha Robotics Co. Ltd.）は、ヤマハ発動機株式会社グループにおいて半導体製造装置（後工程）および電子部品組み立て装置事業を担う会社です。